

## 電子部品パッケージの成形技術

## 巻頭言

- 電子部品パッケージの成形技術 畑 義和 263

## 解説

- 熱粘弾性解析による半導体デバイスの熱応力と反り変形挙動の解明 中村省三 264  
 LCPの溶液キャスト法によるフィルム化 岡本 敏 270  
 半導体デバイス封止における圧縮成形技術 小林一彦 / 小林一彦 / 井出修二 276  
 パウダ/顆粒状樹脂用圧縮成形技術 大西洋平 279  
 熱硬化型液状樹脂の成形加工技術 土橋和夫 284

## 講座 製品機能をアップさせる二次加工技術 接合・融着・多層化技術を中心に

- 2章 高分子材料のレーザー接合技術  
 2.6 レーザー接合の利用事例 小川剛充 / 坪井昭彦 288

## 技術報告

- 自動車関連樹脂部品の衝突解析の現状と今後の課題 一ノ瀬規世 291

## 日本の大学・試験・研究機関の研究 162

- 九州工業大学 情報工学部 機械情報工学科 鈴木・檜原・是澤研究室 鈴木 裕 / 福丸浩史 296

## 海外研究機関の紹介 85

- North Carolina State University College of Textiles 山崎 舞 300

## 会議・見本市だより

- Plastics Extrusion Asia 2008 ( Bangkok ) 参加報告 酒井忠基 303

## 製品・技術紹介

- 新縦型ロータリー式電動射出成形機 MDVR 100 X (株)ニイガタマシンテクノ 306

## 論文

- 溶融混練によるABS樹脂/クレー系ナノコンポジットの作製とその性質  
 山田展也 / 荻原 隆 / 小形信男 / 斎藤修一 / 上山明彦 / 前川知一 / 雲竜常宗 307

- 文献抄録 “ Polymer Engineering and Science ” 315

- 編集後記 316

---

***Special Issue on Polymer Processing Technology for  
Electronic Parts Package***

***Preface***

- Polymer Processing Technology for Electronic Parts Package Hata, Yoshikazu **263**

***Technical Notes***

- Thermal Stress and Warp Deformation Behavior for LSI Devices by Thermo-viscoelastic Analysis  
Nakamura, Shozo **264**
- LCP Film Fabrication by Solvent-Casting Method Okamoto, Satoshi **270**
- Compression Molding for the Semiconductor Devices  
Kobayashi, Kazuhiko/Kobayashi, Kazuhiko/Ide, Shuji **276**
- Compression Molding Technology for Powder/Granulated-Resin Onishi, Yohei **279**
- Molding Technology for Thermosetting Liquid Materials Dobashi, Kazuo **284**

***Special Lecture-Fabrication Techniques Improving Product Function Bonding, Welding, Multilayer and Other Processes***

- Chapter 2. Laser Welding Process of Polymeric Materials
- 2.6 Application of Laser Plastic Welding Ogawa, Takemitsu/Tsuboi, Akihiko **288**

***Technical Report***

- Current Status and Problems of Plastic Crash Simulation in Automotive CAE Ichinose, Noriyo **291**

***Report from Universities and Institutions in Japan*** <sup>162</sup>

- Suzuki, Narahara, Koresawa Laboratory, Department of Mechanical Information Science and Technology,  
Faculty of Computer Science and Systems Engineering, Kyushu Institute of Technology  
Suzuki, Hiroshi/Fukumaru, Hirofumi **296**

***Report from Oversea Universities and Institutions*** <sup>85</sup>

- North Carolina State University College of Textiles Yamazaki, Mai **300**

***Reports of International Meeting***

- Report on Plastics Extrusion Asia 2008 Sakai, Tadamoto **303**

***Topic on Products and Technologies***

- New All Electric Vertical Molding Machine with Rotaly/MDVR 100 X  
Niigata Machine Techno Co., Ltd. **306**

***Original Papers***

- [Preparation and Characterization of ABS Resin/Clay Nanocomposite by Melt Compounding](#)  
Yamada, Nobuya/Ogihara, Takashi/Ogata, Nobuo/Saito, Shuichi  
Ueyama, Akihiko/Maekawa, Tomokazu/Unryu, Tsunemune **307**

- Title Service " Polymer Engineering and Science " **315**

- An Editorial Note **316**